

Übersicht Warengliederung

1	Materialien	4	Inspektions- und Testsysteme
2	Herstellungsverfahren und -technik	5	Bauelemente/Geräte
3	Aufbau- und Verbindungstechnik, Systemintegration	6	Anwendungen
		7	Dienstleistungen und Services

Warengliederung

- | | |
|--|---|
| <p>1 Materialien</p> <p>1.1 Substrate</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1.1 Plastikfolien</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1.2 Metallfolien</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1.3 Papier</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1.4 Glas</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1.5 Textilien</p> <p><input type="checkbox"/> 1.1.6 Sonstige Substrate</p> <p>1.2 Leitende Materialien</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.1 Organische Leiter</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.2 Anorganische Leiter</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.3 Nanomaterialien</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.4 Carbon Nanotubes</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.5 Graphen</p> <p><input type="checkbox"/> 1.2.6 Hybride Leiter</p> <p>1.3 Halbleiter</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3.1 Polymere Halbleiter</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3.2 Halbleiter (kleine Moleküle)</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3.3 Anorganische Halbleiter</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3.4 Nano Halbleiter</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3.5 Carbon Nanotubes (Halbleiter)</p> <p><input type="checkbox"/> 1.3.6 Hybride Halbleiter</p> <p>1.4 Dielektrika</p> <p><input type="checkbox"/> 1.4.1 Organische Dielektrika</p> <p><input type="checkbox"/> 1.4.2 Anorganische Dielektrika</p> <p><input type="checkbox"/> 1.4.3 Nanomaterialien</p> <p><input type="checkbox"/> 1.4.4 Hybride Dielektrika</p> <p>1.5 Verkapselungsmaterialien und Kleber</p> <p><input type="checkbox"/> 1.5.1 Dünnschichtverkapselung</p> <p><input type="checkbox"/> 1.5.2 Polymerverkapselung</p> <p><input type="checkbox"/> 1.5.3 Metallverkapselung</p> <p><input type="checkbox"/> 1.5.4 Glasverkapselung</p> <p><input type="checkbox"/> 1.5.5 Kleber</p> <p><input type="checkbox"/> 1.6 Sonstige Materialien</p> <p>2 Herstellungsverfahren und -technik</p> <p>2.1 Massendruckverfahren</p> <p><input type="checkbox"/> 2.1.1 Tiefdruck</p> <p><input type="checkbox"/> 2.1.2 Offsetdruck</p> <p><input type="checkbox"/> 2.1.3 Flexodruck</p> <p><input type="checkbox"/> 2.1.4 Siebdruck</p> <p><input type="checkbox"/> 2.1.5 Sonstige Massendruckverfahren</p> | <p>2.2 Digitale Druckverfahren</p> <p><input type="checkbox"/> 2.2.1 Inkjetdruck</p> <p><input type="checkbox"/> 2.2.2 Sonstige digitale Druckverfahren</p> <p>2.3 Sonstige Druckverfahren</p> <p><input type="checkbox"/> 2.3.1 Mikrokontaktdruck</p> <p><input type="checkbox"/> 2.3.2 Nano imprint</p> <p>2.4 Vakuumprozesse</p> <p><input type="checkbox"/> 2.4.1 Aufdampfverfahren</p> <p><input type="checkbox"/> 2.4.2 Sputtering</p> <p><input type="checkbox"/> 2.4.3 Organic vapor phase deposition (OVPD)</p> <p><input type="checkbox"/> 2.4.4 Sonstige Vakuumprozesse</p> <p><input type="checkbox"/> 2.5 Fotolithografie</p> <p>2.6 Laserverfahren</p> <p><input type="checkbox"/> 2.6.1 Laserablation</p> <p><input type="checkbox"/> 2.6.2 Lasertransfer</p> <p>2.7 Beschichtungsverfahren</p> <p><input type="checkbox"/> 2.7.1 Rotationsbeschichtung (Spin coating)</p> <p><input type="checkbox"/> 2.7.2 Tauchbeschichtung (Dip coating)</p> <p><input type="checkbox"/> 2.7.3 Rakelbeschichtung (Blade coating)</p> <p><input type="checkbox"/> 2.7.4 Sonstige Beschichtungsverfahren</p> <p>2.8 Materialverarbeitung</p> <p><input type="checkbox"/> 2.8.1 Dispergiertechnik</p> <p><input type="checkbox"/> 2.8.2 Sonstige Materialverarbeitung</p> <p>2.9 Photoinduzierte Prozessierung</p> <p><input type="checkbox"/> 2.9.1 IR Trocknungsverfahren</p> <p><input type="checkbox"/> 2.9.2 UV Verfahren</p> <p><input type="checkbox"/> 2.9.3 Laserverfahren</p> <p>2.10 Dosier- und Mischtechnik</p> <p><input type="checkbox"/> 2.10.1 Pumpen</p> <p><input type="checkbox"/> 2.10.2 Sonstige Dosier- und Mischtechniken</p> <p>2.11 Verkapselungstechnik</p> <p><input type="checkbox"/> 2.11.1 Dünnschichtverkapselung</p> <p><input type="checkbox"/> 2.11.2 Polymerverkapselung</p> <p><input type="checkbox"/> 2.11.3 Metallverkapselung</p> <p><input type="checkbox"/> 2.11.4 Glasverkapselung</p> <p><input type="checkbox"/> 2.11.5 Sonstige Verkapselungstechniken</p> <p><input type="checkbox"/> 2.12 Reinraumtechnik</p> <p><input type="checkbox"/> 2.13 Rolle-zu-Rolle-Verfahren</p> <p><input type="checkbox"/> 2.14 Sonstige Herstellungsverfahren und -techniken</p> |
|--|---|

Warengliederung

info@lopec.com, Tel. +49 89 949-20224/25, Fax +49 89 949-20226
Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München, Deutschland

- 3 Elektronikfertigung, Aufbau- und Verbindungstechnik, Systemintegration**
 - 3.1 Elektrische Verbindungstechnik
 - 3.1.1 Flip Chip
 - 3.1.2 Sonstige Verbindungstechniken
 - 3.2 Laminierung
 - 3.3 Systemintegration
 - 3.4 Hybride Systeme (Polytronik)

- 4 Inspektions- und Testsysteme**
 - 4.1 Elektrische Charakterisierung
 - 4.2 Physikalische/Optische Charakterisierung
 - 4.3 Chemische Charakterisierung
 - 4.4 Simulation/Schaltkreisoptimierung
 - 4.5 Lebensdauertest
 - 4.6 Qualitäts-/Prozesskontrolle
 - 4.7 Umweltprüfverfahren
 - 4.8 Sonstige Inspektions- und Testsysteme

- 5 Bauelemente/Geräte**
 - 5.1 Transistoren
 - 5.2 Dioden
 - 5.3 Passive Bauelemente
 - 5.3.1 Kondensatoren
 - 5.3.2 Widerstände
 - 5.3.3 Sonstige passive Bauelemente
 - 5.4 Integrierte Schaltkreise
 - 5.5 Displays
 - 5.5.1 OLED
 - 5.5.2 Elektrophoretische Displays
 - 5.5.3 Elektrochrome Displays
 - 5.5.4 Elektrolumineszenz-Displays
 - 5.5.5 LCD
 - 5.5.6 Electrowetting
 - 5.5.7 Sonstige Displays
 - 5.6 Photovoltaikzellen
 - 5.6.1 Organische Photovoltaikzellen
 - 5.6.2 Hybride Photovoltaikzellen
 - 5.6.3 Anorganische Photovoltaikzellen

- 5.7 Sensoren
 - 5.7.1 Fotodioden
 - 5.7.2 Drucksensoren
 - 5.7.3 Temperatursensoren
 - 5.7.4 Biomedizinische Sensoren
 - 5.7.5 Gassensoren
 - 5.7.6 Berührungssensoren
 - 5.7.7 Sonstige Sensoren
 - 5.8 Speicherbausteine
 - 5.9 Antennen
 - 5.10 Batterien
 - 5.11 Komponenten für hybride Systeme
 - 5.12 Sonstige Bauelemente

- 6 Anwendungen**
 - 6.1 TFT Backplanes
 - 6.2 Displays
 - 6.3 Sensoren
 - 6.4 Intelligente Systeme
 - 6.5 RFID
 - 6.6 Solarzellen
 - 6.7 Intelligente Textilien
 - 6.8 Lautsprecher
 - 6.9 Beleuchtung
 - 6.10 Sonstige Anwendungen

- 7 Dienstleistungen und Services**
 - 7.1 Consulting
 - 7.2 F&E Förderprogrammmanagement
 - 7.3 F&E/Forschung & Entwicklung
 - 7.4 Prototypenentwicklung
 - 7.5 Auftragsfertigung
 - 7.6 Kapital- und Risikobeteiligungsformen
 - 7.7 Fachvereinigungen und -verbände
 - 7.8 Fachbücher, Fachzeitschriften, Fachverlage
 - 7.9 Sonstige Dienstleistungen